



KMT-1287 LED 有机硅灌封胶

特性

- 双组分加成型硅橡胶
- 高触变性不易流淌
- 优异的光、热稳定性
- 良好的粘接性
- 电性能优异

产品应用

LED 等光电器件的封装

产品性能

固化前

外观	半透明液体
A 组分粘度	12000 mPa s
B 组分粘度	22000 mPa s
混合粘度	20000 mPa s
折射率	1.41

建议固化条件: 80~100°C/1 小时+150°C/3 小时

固化后

硬度	42 Shore A
透光率 (450nm/2mm)	>90%
抗拉强度	4 MPa
断裂伸长率	190%
比重	1.04
体积电阻率	$3 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$
介电强度	23 kV/mm

- 以上数据在 25°C 下测得, 均为非规格值, 使用材料前请进行试验, 确认是否适合使用目的。
- 性能可以根据客户要求进行调整。

使用方法

使用前需将 A、B 包装瓶分别在室温下放置 2~4 小时, 待其恢复到室温后再开启封口, 以防产品吸潮。并用洁净的搅拌棒分别将物料搅拌 3~5 分钟, 使胶液均匀后再倒出。

A、B 组分按重量比 100:100 混合均匀, 在室温下真空或离心脱气, 以除去扰动时混入的空气。

而后根据工艺条件对光电器件进行封装。

使用期: 混合后室温 (25°C) 下 5 小时

使用注意事项



版本: K01131011

KMT-1287 LED 有机硅灌封胶

固化阻碍（催化剂中毒）

有些材料、化合物、固化剂和增塑剂等，会阻碍加成型有机硅材料的固化，主要包括：

- 有机锡和其它有机金属合成物
- 含有机锡催化剂的硅橡胶
- 硫、聚硫化物、聚砷类物或其它含硫物品
- 胺、氨基甲酸乙酯或含胺物品
- 不饱和的碳氢增塑剂
- 某些助焊剂残余物

如果对某物质或材料是否会引起阻碍固化存有疑问，建议做小型测试试验，以确定在此应用中的适用性。

清洗

未固化的胶液可使用丙酮或二甲苯清洗，但水和乙醇达不到清洗效果。

运输及贮存

物料应避免阳光直射，运输及贮存需在低温下进行，推荐 $-25 \sim -5^{\circ}\text{C}$ 。并采取预防措施，保持容器密封，防止物料接触湿气。

包装瓶开启后应尽快使用完，在室温下存放时间不得超过 12 小时，超过 12 小时后应再次密封并在 $-25 \sim -5^{\circ}\text{C}$ 下贮存。

保质期：6 个月

包装

塑料瓶包装，500g/瓶
6Kg/箱